



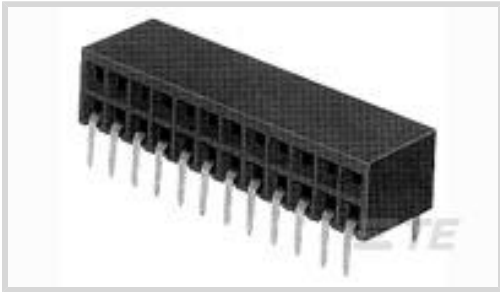
AMPMODU | AMPMODU HV-100/HV-190

TE 内部编号 1-216604-8

AMPMODU HV-100/HV-190, PCB Mount Receptacle, Right Angle,
Board-to-Board, 18 Position, 2.54mm [.1in] Centerline, Gold,
Printed Circuit Board

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: **PCB 安装母端**

PCB 安装方向: **直角**

连接器系统: **板对板**

Number of Positions: **18**

中心线（间距）: **2.54 mm [.1 in]**

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

行数	2
可堆叠	是
PCB 安装方向	直角
Number of Positions	18

主体特性

连接器外形	标准
-------	----

接触件特性

端子保护类型	闭合入口壳体
接合方柱尺寸	.63 mm[.024 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.5 μm
接合插针直径	.63 mm[.024 in]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子形状和构造	正方形



PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.69 mm[.027 in]
端接柱体和尾部长度的	3.2 mm[.126 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准	不带
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

接合入口位置	侧
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
壳体颜色	绿色
外壳材料	聚酯 - GF

尺寸

连接器高度	5.8 mm[.228 in]
Row-to-Row Spacing	7.62 mm[.3 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.062 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

焊接工艺特性	板支座
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------



包装特性

封装数量	42
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-826632-8
18P AMPMODU II STIFT LEI



TE 产品编号 1-826634-8
18P MOD2 STIFT LEI



TE 产品编号 1-826664-8
18P MOD2 STIFT LEI

该系列中的其他产品 | [AMPMODU HV-100/HV-190](#)



板对板接头和插座(347)

客户还购买了



TE 产品编号1-1825006-9
GDS10S04=DIP SW,SLIDE,SMT



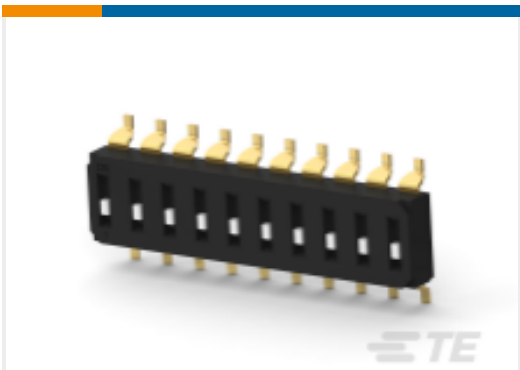
TE 产品编号1-928836-2
MOD2 PIN WITH A-PIN L/P



TE 产品编号3-1415020-1
PT570N20



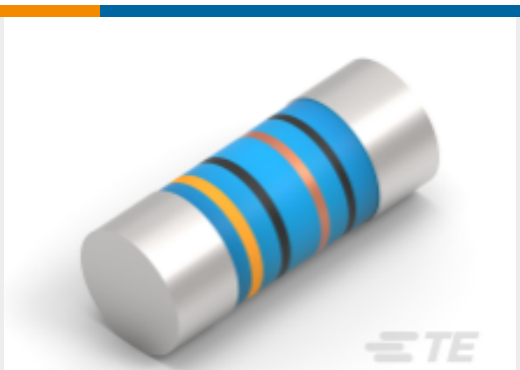
TE 产品编号4-1624112-0
3650 0402 9.0nH 5% 2K RL



TE 产品编号3-2319848-1
END STACK DIP 10P G RECESS SEAL
TUBE



TE 产品编号2331390-1
DET SW5.7X4.0X2.0 GW HORZ. NC
AG RL



TE 产品编号2176314-4
MELF SMA_A 180R 0.1% 15PPM 0102
0.3W

文档

产品图纸

2X18P HV190FEDERLEI

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-216604-8_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-216604-8_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-216604-8_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本